

PCB 板各个层的含义

在 EDA 软件的专门术语中，有很多不是有相同定义的。以下就字面上可能的意义来解释。

Mechanical: 一般多指板型机械加工尺寸标注层

Keepoutlayer: 定义不能走线、打穿孔(via)或摆零件的区域。这几个限制可以独立分开定义。

Topoverlay: 无法从字面得知其意义。多提供些讯息来进一步讨论。

Bottomoverlay: 无法从字面得知其意义。可多提供些讯息来进一步讨论。

Toppaste: 顶层需要露出铜皮上锡膏的部分。

Bottompaste: 底层需要露出铜皮上锡膏的部分。

Topsolder: 应指顶层阻焊层，避免在制造过程中或将来维修时可能不小心的短路 **Bottomsolder:** 应指底层阻焊层。

Drillguide: 可能是不同孔径大小，对应的符号，个数的一个表。

Drilldrawing: 指孔位图，各个不同的孔径会有一个对应的符号。

Multilayer: 应该没有单独这一层，能指多层板，针对单面板和双面板而言。

Toppaste: 也即是面层贴片时开钢网要用的东东。

Bottompaste: 也即是底层贴片时开钢网要用的东东。